(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
18. März 2010 (18.03.2010)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2010/029075 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:
H01L 21/683 (2006.01) *H01L 21/60* (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2009/061634

(22) Internationales Anmeldedatum:
8. September 2009 (08.09.2009)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
61/095,417 9. September 2008 (09.09.2008) US

(71) Anmelder *(für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US)*: **KULICKE AND SOFFA DIE BONDING GMBH** [CH/CH]; Andhausen 52, CH-8572 Berg (CH).

(72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder *(nur für US)*: **TRINKS, Joachim** [CH/CH]; Bergstrasse 11, CH-9230 Flawil (CH).

(74) Gemeinsamer Vertreter: **KULICKE AND SOFFA DIE BONDING GMBH**; attn. Dr. Thomas Körner, Andhausen 52, CH-8572 Berg (CH).

(81) Bestimmungsstaaten *(soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart)*: AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten *(soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart)*: ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

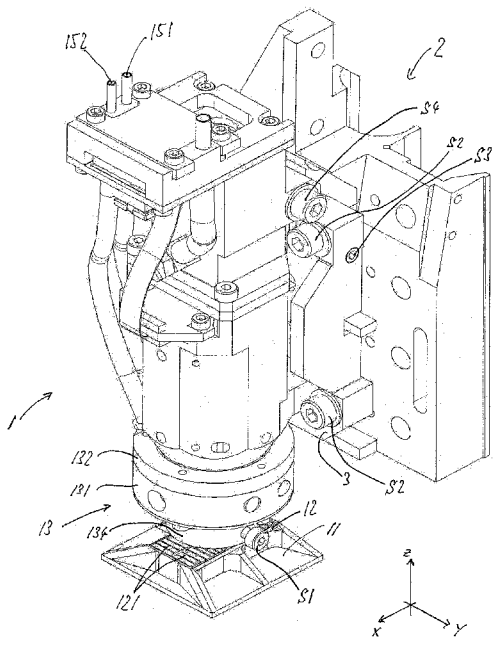
Erklärungen gemäß Regel 4.17:

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) **Title**: ROTATABLE, HEATABLE PLACEMENT TOOL AND CHIP MOUNTING SYSTEM COMPRISING SUCH A PLACEMENT TOOL

(54) **Bezeichnung** : DREHBARES, BEHEIZBARES PLATZIERWERKZEUG UND CHIPMONTAGEAUTOMAT MIT EINEM SOLCHEN PLATZIERWERZEUG

Fig. 1



(57) **Abstract**: A placement tool, which can move in the direction of a z-axis perpendicular to a substrate, comprises: a carriage element for a semiconductor component, said carriage element comprising a heating element; a receptacle for the carriage element, said receptacle being mounted rotatably about the z-axis at the placement tool and comprising an insulation member made of thermally insulating material; a drive for the receptacle for rotating the receptacle about the z-axis; and a feed for a cooling fluid for cooling the receptacle for the carriage element.

(57) **Zusammenfassung**: Ein Platzierwerkzeug, welches in Richtung einer z-Achse senkrecht zu einem Substrat bewegbar ist, umfasst: ein Halteelement für ein Halbleiterbauelement, welches ein Heizelement aufweist; eine Aufnahme für das Halteelement, welche drehbar um die z-Achse am Platzierwerkzeug gelagert ist und einen Isolationskörper aus wärmeisolierendem Material aufweist; einen Antrieb für die Aufnahme, mittels welchem die Aufnahme um die z-Achse gedreht werden kann; und eine Zuführung für ein Kühlfluid, mittels welchem die Aufnahme für das Halteelement gekühlt werden kann.

WO 2010/029075 A1

— *hinsichtlich der Identität des Erfinders (Regel 4.17 Ziffer i)*

— *Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv)*

Veröffentlicht:

— *mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)*